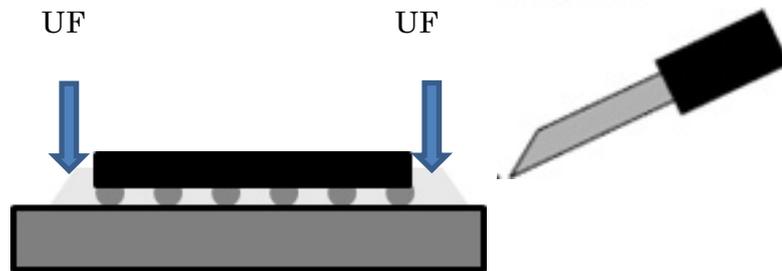


【アンダーフィル PKG のリワークプロセス】

※ リワーク可能なアンダーフィル材使用の場合です。

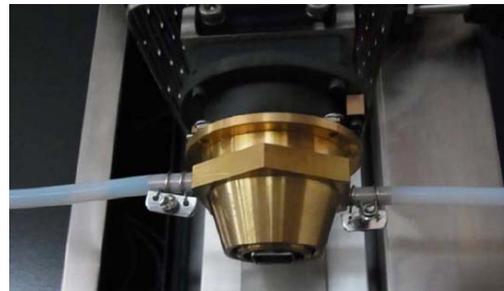
① 事前作業のプロセス



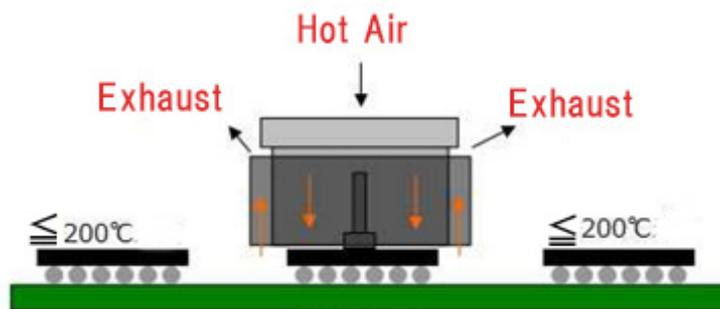
*アンダーフィル材が CSP 周辺に充填されている場合、事前にはんだごて（先端がナイフ状のもの）などで削り取っておきます。

② MS9000SE-UFN ノズルによる加熱

アンダーフィル材が CSP ランド側への充填である場合、UFN 型ノズルで加熱します。

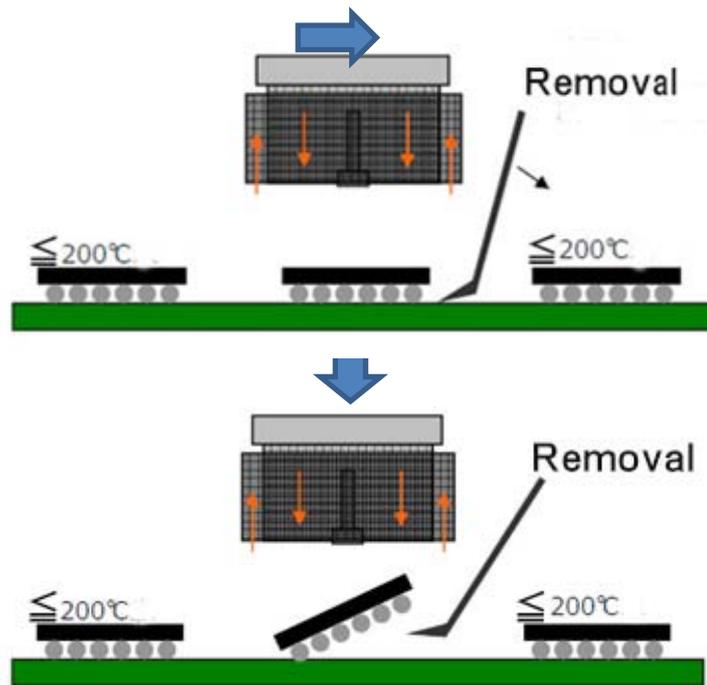


MS9000SE-UFN ノズル



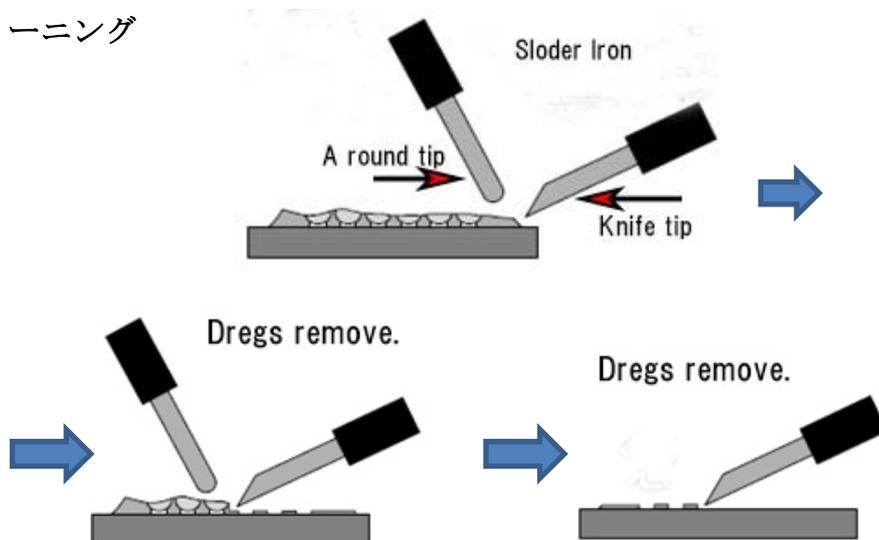
MS9000SE-UFN ノズルで加熱した場合、隣接部品への熱影響を減らすことができます、245℃加熱の場合に 1.0mm 以上離れている部品は 200℃以下に抑えられるでしょう。

③ 取り外し



加熱後の CSP 取り外しは、歯石除去用ツールなどを利用して CSP の下部に差し込み挟むようにして取り外します。

④ クリーニング



CSP を取り外した後の基板上のランドをはんだごてなどを使って手作業でクリーニングします。先端が丸形とナイフ状のはんだごてを使用して、ランドに傷をつけないよう丁寧に残滓を除去します。最後に溶剤ウイックなどを併用して仕上げてください。